

セラミックスパウダー・セラミックス基板

セラミックスパウダー

窒化アルミニウムパウダー (AlN)

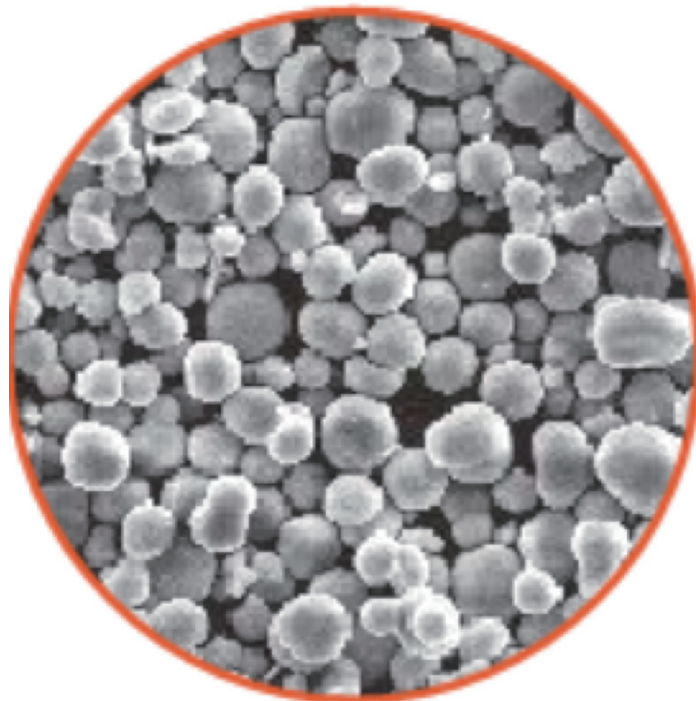
放熱マネジメントに最適な高性能セラミックスフィラーです。

特 徴

- 形状バリエーション:粉末(不定形、丸み状)、顆粒(球状)の幅広くラインナップ
- 表面处理:加水分解抑制技術による耐水性向上と樹脂親和性を最適化する表面处理品

用 途

- 放熱シート
- 放熱グリース
- 放熱接着剤
- セラミックス焼結用原料
- LED用放熱基板



窒化ホウ素パウダー (BN)

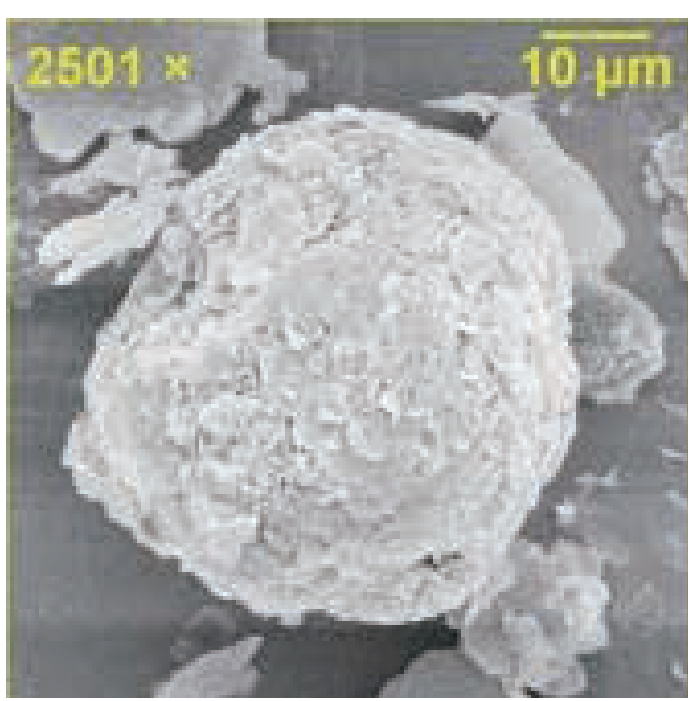
高い熱伝導率、優れた電気絶縁性低硬度を兼ね備えた白色粉末であり、黒鉛に類似した鱗片状の結晶構造を有します。

特 徴

- 多彩な形状:鱗片状や凝集体、球状凝集体など用途に応じた選択が可能
- 表面处理技術:シランカップリング剤による表面改質で樹脂との親和性を向上。

用 途

- CCLの絶縁フィラー
- 放熱接着剤
- パッド
- 放熱グリース
- 放熱ジェル
- 相変化材料(PCM)



セラミックス基板

ラップ研磨、鏡面研磨の加工、メタライズの提供も対応可能です。

窒化ケイ素

熱伝導率	≥80w/(m-k)
曲げ強度	700MPa
絶縁破壊電圧	≥20KV/mm
サイズ	190.0×138.0mm、114.3×114.3mm
厚み	0.254、0.32、0.635、1.0mm

窒化アルミニウム

原料粉末から一貫生産をしています

熱伝導率	170～250w/(m-k)
曲げ強度	>400MPa (170w/(m-k)品)
絶縁破壊電圧	>17KV/mm
最大サイズ	200×200mm
厚み	0.2～3.0mm

アルミナ

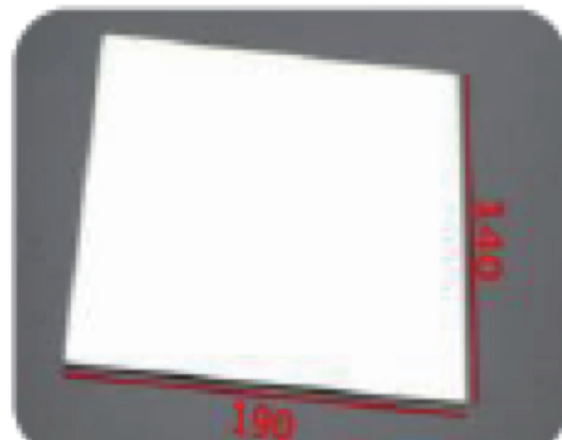
熱伝導率	>29w/(m-k)
曲げ強度	>500MPa



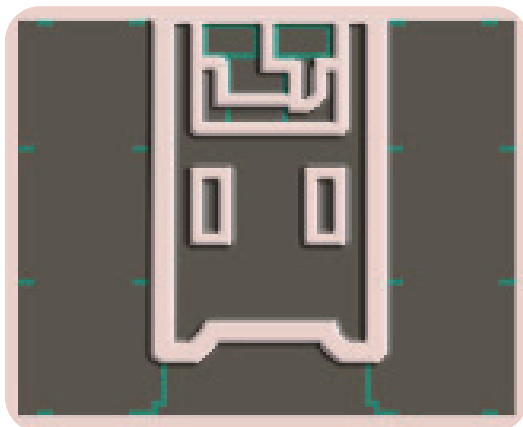
窒化ケイ素(Si₃N₄)



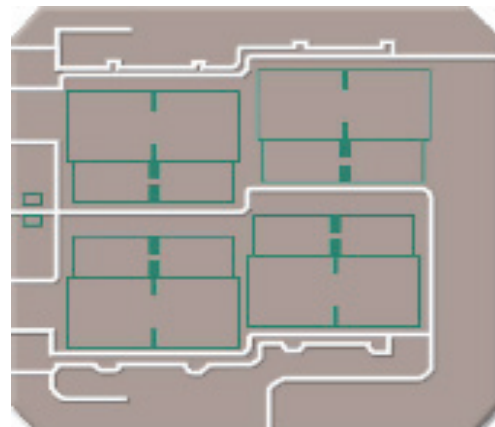
窒化アルミ(AlN)



アルミナ(Al₂O₃)



AMB



DBC



巴工業株式会社

商品の詳細は
こちら

